

8인치 반도체 및 태양광 기판 핸들링용 고정밀 ESD 세이프 Peek 웨이퍼 진공 흡착 펜

품목 번호: PL-CP115



소개

정밀 반도체 및 태양광 8인치 웨이퍼 핸들링을 위해 설계된 고성능 ESD 세이프 PEEK 웨이퍼 진공 흡착 펜입니다. 이 맞춤형 솔루션은 중요한 클린룸 환경과 민감한 기판 이송 공정을 위해 우수한 화학적 저항성과 기계적 내구성을 제공합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
웨이퍼 검사	광학 또는 SEM 검사 스테이션으로부터/으로의 8인치 실리콘 웨이퍼 수동 이송.	최소 접촉 면적이 표면 결함 발생 위험을 줄입니다.
태양광 전지 분류	조립 및 테스트 단계 동안 고효율 태양전지의 핸들링 및 분류.	부드러운 진공 그립을 통해 미세 균열을 방지하고 전지 효율을 유지합니다.
젯 벤치 공정	습식 화학 환경에서 화학 배스 또는 린싱 스테이션 간 기판 이송.	가혹한 공정 화학 물질 및 습기에 대한 탁월한 저항성.
박막 증착	PVD/CVD 진공 챔버 또는 로드 락으로부터/으로의 기판 배치 및 제거.	고온 증착 사이클 후 핸들링을 가능하게 하는 높은 열 안정성.
클린룸 연구개발	첨단 소재 연구개발 시설에서의 일반 기판 핸들링.	입자 비산을 최소화하여 엄격한 ISO 청정도 표준을 유지합니다.
다이 본딩 준비	다이싱 또는 후속 다이 본딩 작업을 위한 웨이퍼의 수동 포지셔닝.	ESD 세이프 특성이 민감한 마이크로 회로의 잠재적 결함을 방지합니다.
LED 기판 핸들링	LED 칩 제조 중 사파이어 또는 SiC 기판의 정밀 조작.	미끄러짐이나 긁힘 없이 단단하고 연마된 표면에 안전한 그립.

사양 카테고리	PL-CP115 사양 상세
모델 식별	PL-CP115 시리즈
주요 소재	고성능 ESD 세이프 PEEK
기판 호환성	완전 맞춤형 (8인치/200mm 웨이퍼에 최적화)
표면 저항	지정된 ESD 세이프 범위로 맞춤 설정 가능 (예: $10^6 - 10^9 \Omega$)
작동 온도 범위	공정 요구 사항에 기반한 맞춤형
화학적 호환성	범용 (대부분의 산, 염기 및 용제에 대해 높은 저항성)
진공 연결 타입	시설 진공 라인 또는 휴대용 펌프에 맞는 맞춤형 사이징
팁 구성	요청 시 맞춤 형상 제공 가능 (평평, 곡선, 다중 포인트)
클린룸 등급	ISO Class 3 - 8 호환 (응용 분야에 따라 다름)
제조 방법	맞춤형 사양에 따른 정밀 CNC 가공
핸들 치수	고객 선호도에 맞춤 인체공학적 맞춤형